

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年3月23日(2017.3.23)

【公表番号】特表2016-510170(P2016-510170A)

【公表日】平成28年4月4日(2016.4.4)

【年通号数】公開・登録公報2016-020

【出願番号】特願2015-559577(P2015-559577)

【国際特許分類】

H 01 L	33/62	(2010.01)
H 01 L	33/52	(2010.01)
H 01 L	33/50	(2010.01)
H 01 L	23/12	(2006.01)
H 01 L	23/14	(2006.01)

【F I】

H 01 L	33/00	4 4 0
H 01 L	33/00	4 2 0
H 01 L	33/00	4 1 0
H 01 L	23/12	F
H 01 L	23/14	R

【手続補正書】

【提出日】平成29年2月14日(2017.2.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

それぞれ少なくとも1つの対の逆並列配向LEDを含む、容量性駆動に適した複数のLEDパッケージであって、前記LEDは、当該LEDの対向する表面においてアノード端子及びカソード端子を具備されており、前記LEDは、誘電材料の2つの実質的に平行の基板の間に挟まれてあり、前記基板は、当該基板の対向する面において電気伝導性材料の薄膜を設けられており、これにより、前記端子と前記電気伝導性材料の薄膜との間ににおいて電気的コンタクトが存在するように構成されている、複数のLEDパッケージを含むLEDアセンブリであって、前記LEDパッケージは、2つの支持層の間に挟まれてあり、前記支持層は、当該支持層の対向する面において電極層を具備されており、前記電極層のそれぞれは、前記LEDパッケージの前記基板と接触しており、前記電極層は、AC電源に電気的に接続するための電源端子を備えられている、LEDアセンブリ。

【請求項2】

請求項1に記載のLEDアセンブリであって、前記電気伝導性材料は、金属又は合金、好ましくは貴金属(合金)、より好ましくは金(合金)を含む、LEDアセンブリ。

【請求項3】

請求項1又は2に記載のLEDアセンブリであって、前記基板は、一層の樹脂材料、好ましくはポリフッ化ビニリデン樹脂材料、を含む、LEDアセンブリ。

【請求項4】

請求項1乃至3の何れか一項に記載のLEDアセンブリであって、前記基板の間ににおける空間の少なくとも一部は、光学的に透明な封止材料で充填されている、LEDアセンブリ。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の L E D アセンブリであって、前記封止材料は、散乱粒子を含む、 L E D アセンブリ。

【請求項 6】

請求項 4 又は 5 に記載の L E D アセンブリであって、前記封止材料は蛍光体粒子を含む、 L E D アセンブリ。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 の何れか一項に記載の L E D アセンブリであって、前記支持層の両方は、前記 L E D パッケージにより発せられ得る L E D 光に関して光学的に透明である、 L E D アセンブリ。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の L E D アセンブリであって、前記支持層のうちの少なくとも 1 つは、ガラスからなっている、 L E D アセンブリ。

【請求項 9】

請求項 1 乃至 8 の何れか一項に記載の L E D アセンブリであって、前記電極層は、透明材料、好ましくは I T O 及び A T O のうちの少なくとも 1 つ、を含む、 L E D アセンブリ。

【請求項 10】

請求項 1 乃至 9 の何れか一項に記載の L E D アセンブリであって、前記電源端子は、前記支持層の縁部に配置される、 L E D アセンブリ。

【請求項 11】

請求項 10 に記載の L E D アセンブリであって、前記電極層は、前記支持層の前記縁部まで延在し、前記電源端子は、前記支持層の前記縁部の周りにおいてクランプする、 L E D アセンブリ。

【請求項 12】

L E D パッケージの容量性駆動のための回路であって、請求項 1 乃至 11 の何れか一項に記載の L E D アセンブリ、及び前記電極層へ接続される A C 電源を含む、回路。